

決算説明資料

Mipox株式会社(マイポックス)

証券コード 5381

イノベーションに 磨きをかける。

イノベーションに磨きをかける。

最先端を研ぎ澄ます。

次の100年を切り開き、世界の常識を塗り替える。

日本には「つゆはらい」という言葉があります。 行列の先を行って障害を取り払うこと。

人々を先導すること。

転じて、何かを最初に行うこと。

お客様が進む未来の先に立ち塞がる課題を、先回りして取り除いておく。 世の中に横たわる課題に、まだ来ない誰かが躓かないように解決しておく。

100年にわたり「塗る・切る・磨く」ソリューションを提供してきた 私たちの仕事は、お客様と社会の行く先に磨きをかけること。 そして皆さんと切磋琢磨しながら、 私たち自身の技術にも磨きをかけることに他なりません。

これからの 100 年も、 未来が、眩しく光輝くように 私たちは、強く優しく磨き続けます。



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

_2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 Q1 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Busines

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix



会社名 Mipox (マイポックス) 株式会社

英文名 Mipox Corporation

創業 大正14年(1925)年11月21日

設立 昭和16年(1941)年12月12日

代表取締役社長 渡邉 淳(Jun Watanabe)

本店・本社 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18

株式市場名 東京証券取引所 スタンダード

証券コード 5381









8 スガ コーディングス

経営方針

エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値向上



受託事業から エンジニアリングサービス事業への転換 早い変化と多様性に対応できる 経営基盤の整備

「塗る、切る、磨く」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業です。 コア技術を組み合わせ、お客様の成功のための付加価値を創造するための製品とサービスを提供します。

塗る Coating

PETフィルム、銅箔、織布、紙等の基材に、調合した樹脂等の塗料を均一に塗布。 自社製品である研磨材や反射材だけでなく、 保有する複数の塗工機によって要望に合わ せた機能性フィルムの製造も実現。



切る Slitting

「塗る」ことで出来た製品を希望のサイズ に裁断(スリット)。

高精密さが求められるハードディスク向け 研磨フィルムの製造で培った技術によって、 裁断が困難といわれている素材でも精度の 高い切り口と巻き上げを実現し、高品質の 製品を提供。

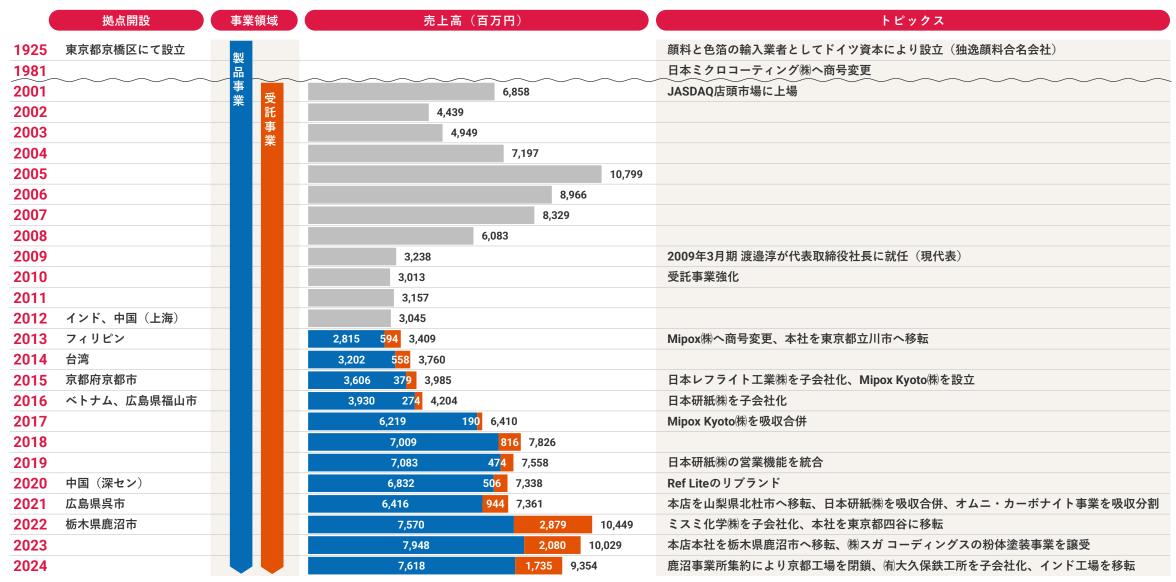


磨く Polishing

徹底的な顧客視点を持った製品開発のため に自社の研磨材と独自の研磨装置で研磨プロセスの研究を積み重ねる。

ハイテク分野で培った高精度研磨加工技術 で次世代半導体ウェーハの研磨にも挑戦し、 研磨市場に於けるプロフェッショナルを目 指す。





製品事業

研磨材の製造・販売

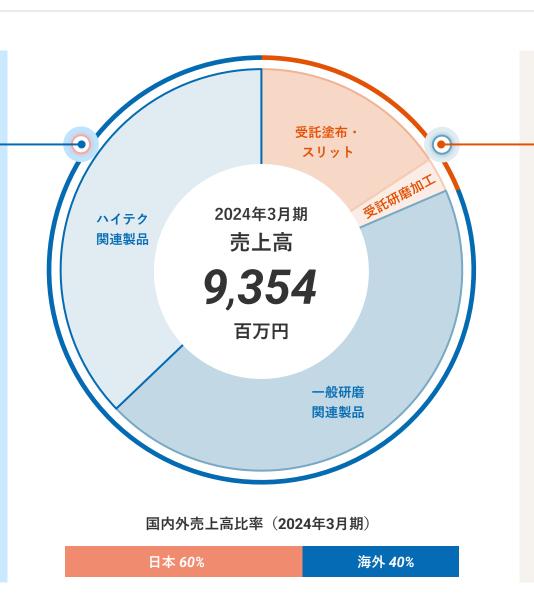
売上高 構成比 **81**%

ハイテク 37% 関連製品

HDD関連、半導体、光ファイバー等で使用される研磨材の製造・販売

一般研磨 関連製品 44%

自動車、鉄鋼関連等で使用される 研磨材の製造・販売



受託事業

研磨材の製造・販売

売上高 構成比 19%

受託塗布・16%

顧客からフィルムや塗料材等を預かり、 当社設備を使用して加工製造

受託研磨 3%

半導体用途を中心にウェーハ等の材料 を預かり、当社の研磨材と設備を使用 して研磨加工

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 Q1 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Busines:

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

売上高

2,565_{百万円}

前年同期比較

698百万円 増加 (+37.4%)

経常利益

382百万円

前年同期比較

613百万円 增加 (-%)

営業利益

286百万円

前年同期比較

623百万円 增加 (-%)

親会社株主に帰属する当期純利益

405百万円

前年同期比較

580百万円 増加 (-%)

自己資本比率

48.4%

前年同期比較

1.6_{pt}增加

*増減算出後、百万未満切捨て

業績概要

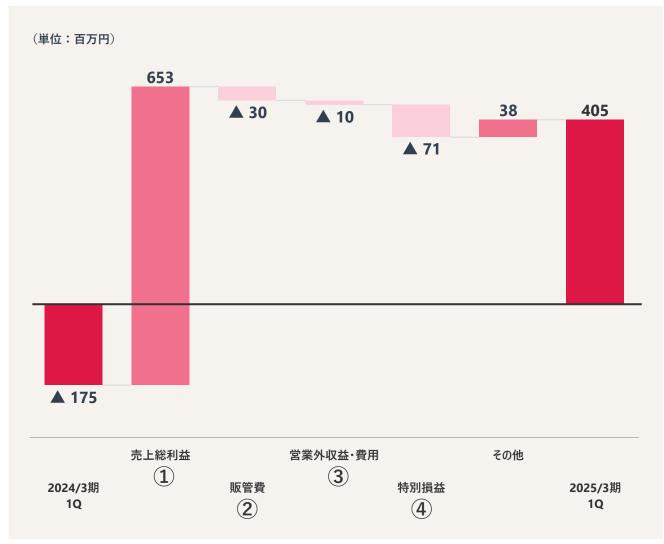
2024年3月期下半期から続くハイテク関連製品の需要回復は顕著であり、これにより売上高が増加いたしました。これら製品の利益率は相対的に高く、左記の利益計上の主な要因となりました。

2025年3月期下半期以降は、減速する可能性もあるため市場環境を見極めてまいります。

当第1四半期の受託事業は対前年同期比で売上高は増加しておりますが、第2四半期以降は弱含みの状態です。引き続き着実な試作の高評価の獲得およびその量産化を狙ってまいります。

(単位:百万円)	2024/3期 1Q	2025/3期 1Q	前年同期比
売上高	1,867	2,565	37.4%
売上総利益	409	1,063	159.3%
販売費及び一般管理費	746	776	4.0%
営業利益	▲ 336	286	-
為替差益	90	75	▲17.1 %
経常利益	▲ 231	382	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	▲ 175	405	_

^{*}百万円未満切り捨て、業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。



*増減算出後、百万未満切捨て

利益增減要因

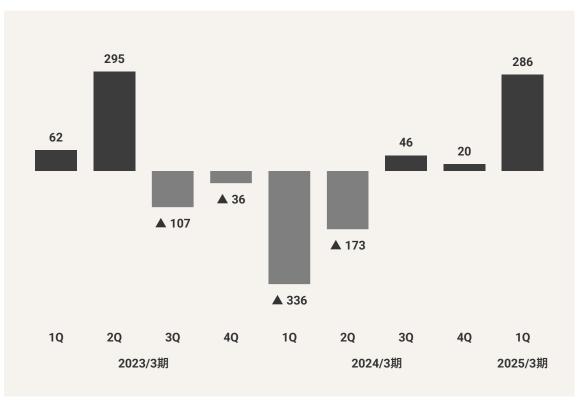
- ① ハイテク関連製品はニッチトップ商材が多く、相対的に利益率が高い製品です。過年度と比較し、原材料やエネルギー費用の高騰は継続しておりますが、売上原価の増加は限定的です。
 - HDD、光ファイバー、半導体(消耗材)の全てにおいてハイテク関連製品が大きく増加いたしました
- ② ベースアップを含む人件費の増加が主な要因です。
- ③ 為替差益の計上額が減少しております。
- ④ 前年同期では一過性の海外子会社清算益が計上されていましたが、当第1四半期は計上がございません。

製品事業はハイテク関連製品が牽引し、回復傾向が続いています。前四半期と比較して売上は若干減少したものの、比較的高価格な研磨装置の売上計上がない状況でも高い水準を維持しました。また、ハイテク関連製品は相対的に利益率が高く、全体的な利益に大きく寄与しました。受託事業では、塗布・スリット加工分野で増収を達成しましたが、研磨加工分野では子会社である大久保鉄工所の貢献により増収したものの、セグメント損失が続いています。

売上高・営業利益率 (単位: 百万円・%)



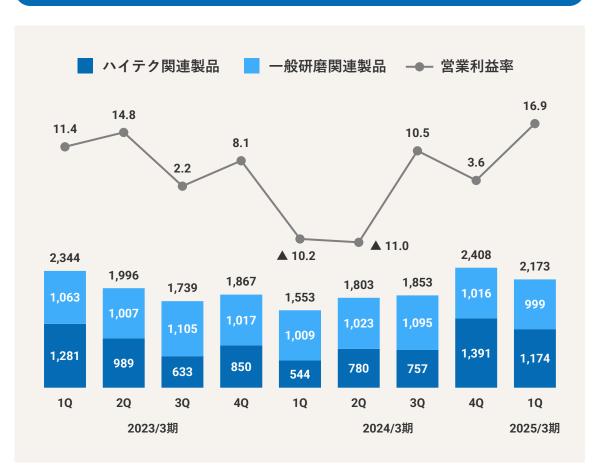
営業利益(単位:百万円)



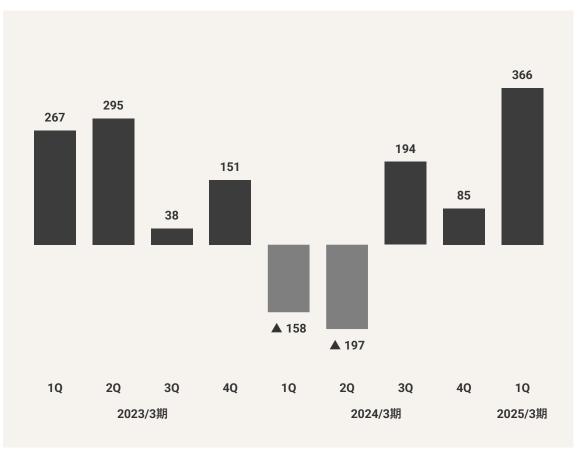
*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

ハイテク関連製品の売上高が前年同期比で2倍超、一般研磨関連製品は微減となりました。 ハイテク関連製品の利益率は相対的に高く、高い営業利益率を計上しています。

売上高・営業利益率 (単位: 百万円・%)



営業利益 (単位: 百万円)

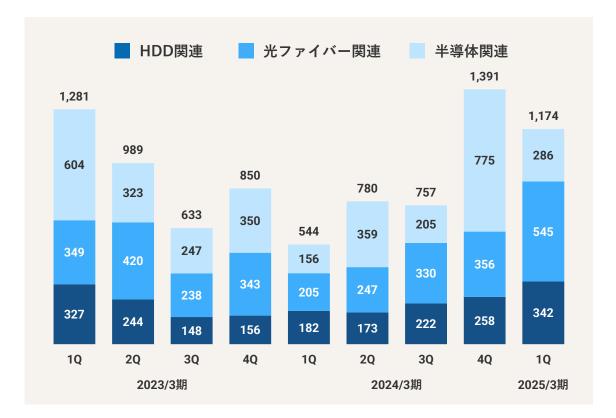


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

ハイテク関連製品は2024年3月期上半期は低調であったものの、同下半期から回復傾向に入り、当第1四半期も継続しております。 AIサーバー投資が活発化し、抑制されていた汎用データセンター投資が復調傾向です。これによる半導体およびハードディスク市場の他、光ファイバー市場の回復がみられます。

一般研磨関連製品は、総じて安定的に推移しています。一部製品の製造原価上昇分の価格転嫁も進めています。

ハイテク関連製品(単位:百万円)



一般研磨関連製品(単位: 百万円)

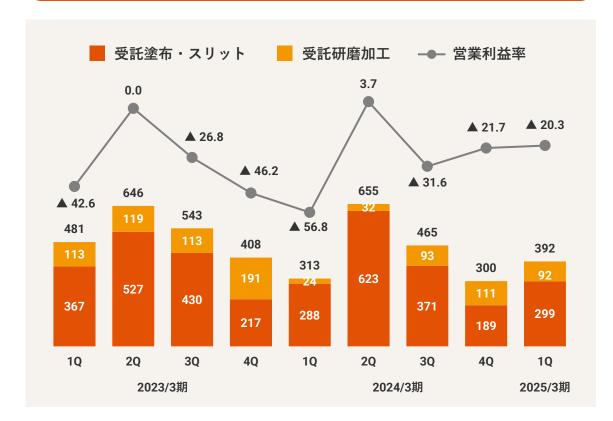


*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

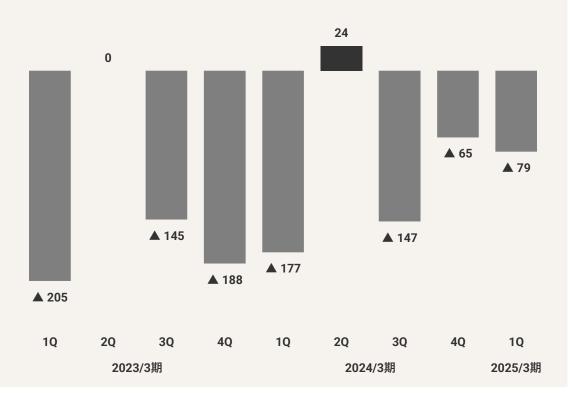
受託塗布・スリットはスマートフォンやPC、タブレット等のエレクトロニクス製品向け用途が多く、対象製品の需要動向の影響を受けます。当第1四半期では対前年同期比で売上高が増加しましたが、第2四半期以降は弱含みの見込みです。

受託研磨加工は一般研磨受託加工を担う子会社である大久保鉄工所の貢献により、売上高は増加しています。一方、難易度が高く高付加価値である 先端材料等の受託量の増加は限定的であり、セグメント損失の計上が続いています。

売上高・営業利益率 (単位: 百万円・%)



営業利益(単位:百万円)



*業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

(単位:百万円)	2024/3期末	2025/3期 6月末	増減額	備考
流動資産合計	8,773	9,332	+559	
現金及び預金	2,692	2,722	+30	
売上債権*	3,063	3,075	+12	
棚卸資産	2,670	3,007	+336	検収期日が近い機械装置製品の在庫計上
その他	347	527	+180	システム利用料の前払費用等
固定資産合計	7,203	7,239	+35	
有形固定資産	6,596	6,647	+51	
資産合計	15,977	16,572	+594	
流動負債合計	4,930	5,417	+487	
支払手形及び買掛金	679	870	+190	
短期借入金(社債含む)	3,032	3,231	+199	
その他	165	175	+10	賞与引当金の増加等
固定負債合計	3,563	3,134	▲ 429	
長期借入金(社債含む)	3,141	2,813	▲327	
負債合計	8,493	8,552	+58	
純資産合計	7,484	8,019	+534	
負債純資産合計	15,977	16,572	+594	

^{*}売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品および製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2024年7月10日	2Q	東京オフィスの移転	<u>別途資料</u>
2024年7月4日	2Q	「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築/次世代パワー半導体に用いるウェーハ技術開発/超高品質・8インチ・低コスト SiCウェーハ開発」成果報告書および事業戦略ビジョン公開のお知らせ	<u>P20</u> 別途資料
2024年6月5日	1Q	中国拠点 深センオフィス移転のお知らせ	<u>別途資料</u>
2024年5月30日	1Q	Mipox、「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」に IH(高周波誘導加熱)粉体塗装システムが採択	P19
2024年5月21日	10	新拠点「熊本サテライト」に関するお知らせ	<u>別途資料</u>
2024年5月15日	1Q	新製品「SiC (炭化ケイ素) 8インチ半導体ウェーハ専用研磨装置」の提供開始に関するお知らせ	P18
2024年4月26日	1Q	レーシングドライバー根本悠生選手とスポンサー契約締結のお知らせ	P18



名前	根本 悠生 (ねもと ゆうき)
生年月日	1996年9月22日(27歳)
出身地	東京都
直近の 戦歴/受賞歴	2021年 International GTOPEN Championship プロクラス4位 2022年 Campeonato Italiano GT Enduranceシリーズチャンピオン 2023年 Fanatic GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup Silver フル参戦
コメント	Mpox様とのスポンサー契約を通じて、私のモータースポーツ活動だけでなく、自動車産業全体の発展に寄与する素晴らしい機会にできることを非常に楽しみにしております。このパートナーシップが新たな展開をもたらし、自動車産業全体の進化に寄与できることを誇りに思うとともに、更なる世界での活躍に向けより一層努力してまいります。

新製品「SiC(炭化ケイ素)

2024年5月15日リリース

8インチ半導体ウェーハ専用研磨装置」の提供開始

精密研磨分野で培ってきた強みを活かし、受託研磨加工サービスを強化する一貫として、SiC8インチ半導体ウェーハのノッチ/外周に特化した専用仕様の研磨装置を開発し、Mpoxの研磨フィルムを使用することで安定した面取り加工を施せる工法を確立いたしました。

【SiCウェーハ エッジ部(外周部)】







面取り加工前



面取り加工後

【SiCウェーハ エッジ部(外周部)】



面取り加工中



面取り加工前



面取り加工後

2024年5月30日リリース

Mipox、「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」にIH(高周波誘導加熱)粉体塗装システムが採択

IH(高周波誘導加熱)粉体塗装システムが令和5年度補正予算「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(通称:省エネ補助金)」「工場・事業場型」における「先進設備・システム」に採択されましたことをお知らせします。

【補助金の概要】

省エネ補助金は、先進的な省エネ設備や、工場・事業場に合わせ、電化や脱炭素目的の設備等の更新費用の一部の補助を受けることが可能となります。

採択を受けたことにより、当システムを導入するお客様は一部の補助を受けること が可能となります。

【IH粉体塗装システムについて】

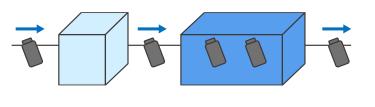
塗装焼付乾燥工程および熱処理工程において、化石燃料から電気への転換を実現するための設計をしております。これにより、省エネルギー、省スペース、脱炭素を実現、環境に優しい製造プロセスをご提案いたします。

対象物に合わせて効率的に加熱できるフレキシブルなコイルも設計いたします。

(特許申請中:特開2022-021618)

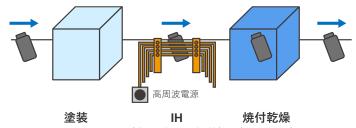
【IH粉体塗装システム導入イメージ】





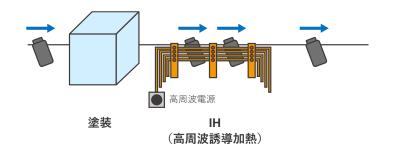
塗装 焼付乾燥 (ガス供給)

電気とガスのハイブリッド乾燥のイメージ



(高周波誘導加熱)(ガス供給)

電気のみの乾燥システムイメージ



2024年7月4日リリース

「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築/次世代パワー半導体に用いるウェーハ技術開発/超高品質・8インチ・低コスト SiC ウェーハ開発」成果報告書および事業戦略ビジョン公開のお知らせ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築/次世代パワー半導体に用いるウェーハ技術開発/超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発」における当社の成果報告書および事業戦略ビジョンの更新版がNEDOのホームページに公開されましたので、お知らせいたします。

【成果報告書概要】

研究開発項目	成果		
大口径ウェーハ加工用ラインの開発	• 各装置仕様の確定後、テスト加工により仕様の検証をおこない、詳細工程フローに即したレイアウトにて購入装置を設置した。		
ウェーハ加工工数削減技術の開発	・ 工程数を3工程減らせる可能性を見出すことができた。 ・ 機械学習モデルの構築を実施し、構築した機械学習モデルを用いて、カスケード最適化アルゴリズムの開発を行った。		
	・ 小径溶液法SiC ウェーハの偏光観察を実施した結果、偏光観察で昇華法SiC 結晶同様にウェーハ内部の歪・転位の観察が可能で あることを確認し、溶液法SiC 結晶に向けた光学系仕様を決定して光学観察系を開発した。		
溶液法結晶の評価技術の確立	・ 位相演算において、新規のフィルタ処理やアリゴリズムを開発し、良好なコントラストを得ることに成功した。		
	8 インチ対応のオートステージを選定し原理検証機を製作した。装置筐体は正立型と倒立型を製作し、前者はメンテナンス性に 優れること、後者は観察の安定性に優れることを確認した。		

詳細はこちらをご覧ください

https://www.mipox.co.jp/dcms_media/other/ir_20240704.pdf



Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 Q1 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Busines

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix



(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
当初予想(A)	10,000	300	300	200
修正予想(B)	10,000	700	800	600
2024年3月期実績	9,354	▲442	▲186	▲409
増減額(B-A)	0	+400	+500	+400
増減率	-	+133.3%	+166.7%	+200.0%

*増減算出後、百万未満切捨て

コメント

当社のハイテク関連製品の売上高は、世界的な汎用データセンター投資の回復を主因とした、光ファイバー、半導体およびハードディスク市場の好況に牽引され増加しました。売上構成の変化により通期売上高は前回発表した予想とほぼ同水準で推移する見込みですが、これらのハイテク関連製品は相対的に利益率が高いため、営業利益、経常利益、および親会社株主に帰属する四半期純利益が計画を大幅に上回りました。この結果を踏まえ、通期連結業績予想を上記の通り修正いたしました。

ハイテク関連製品

- 2024年3月期からの米国の光ネットワークインフラ整備や生成AI関連のデータネットワーク設備強化の動きから、光ファイバー関連製品が好調を維持 しております。
- HDDも在庫調整が一巡し、さらに汎用データセンターへの投資回復により、当社関連製品の売上も好調に推移しております。
- 半導体関連製品においては、半導体工場の稼働率は依然として低いものの2024年3月期からの復調から、プローブカードクリーニング製品やSiCウエ ハー用研磨フィルムの販売が増加傾向にあります。

一般研磨製品

- ・ 底堅い需要がある製品用途のため、前期同様の売上で推移する見込みです。このうち、自動車関連用途は半導体不足が解消された反面、検査工程などの 不正による影響もあり、先行きに不透明感があります。建築関連用途は特に中国市場の鈍化で厳しい状況が継続する見込みです。造船用途は海外から船 の受注が増えていることもあり、対前年比で大きく上振れしております。
- 原材料やエネルギーコストの高騰については、ピークは過ぎたものの依然として厳しい状況が継続しております。これに対し、事業所のコストダウンや 製品の値上げを進めております。
- ・ 脱炭素の取組として溶剤フリーの一般研磨製品の開発が進んでおり、2025年3月期中には試作ラインの立上げを目指して進めています。
- ・ 2024年3月には福山事業所へ太陽光パネルの設置が完了しており、消費電力の約8%削減に成功しています。

受託塗布・スリット

- 既存ビジネスは、主要用途である電子デバイスむけサービスが上期後半を目途にピークを迎える見込みです。下期は来期量産に向けた試作中心となり 売上は減少する見込みです。
- 来期以降の新規顧客獲得に向けて精力的に取り組んでおり、試作件数が増加しております。しかしながら、最終製品の市場動向や開発状況により量産 開始まで時間を要する見込みです。そのため、同一設備で自社むけ製品の開発も進め、設備稼働率の向上を目指しております。

受託研磨加工

- 半導体関連展示会SEMICONへの出展を契機に受注は増加傾向にありますが、試作目的が多く、量産加工の獲得には時間を要する見込みです。
- 注力している先端材料の高難度加工技術の実績積上げにより、GaN基板、ダイヤモンド基板など次世代パワーデバイス用基板の研磨受託加工が増加し ています。
- また、新製品として発表したSiC基板用ノッチ・エッジ研磨装置について、設備導入検討と合わせた受託研磨加工のニーズが高まっております。

年間配当

2024年3月期

無配

2025年3月期

未定

事業環境が絶え間なく変化している状況により、当期配当金の予想については未定としております。 当期配当金につきましては、配当方針に従い、決定次第速やかに開示いたします。

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

_2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 Q1 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecas

04

事業内容

Our Business

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

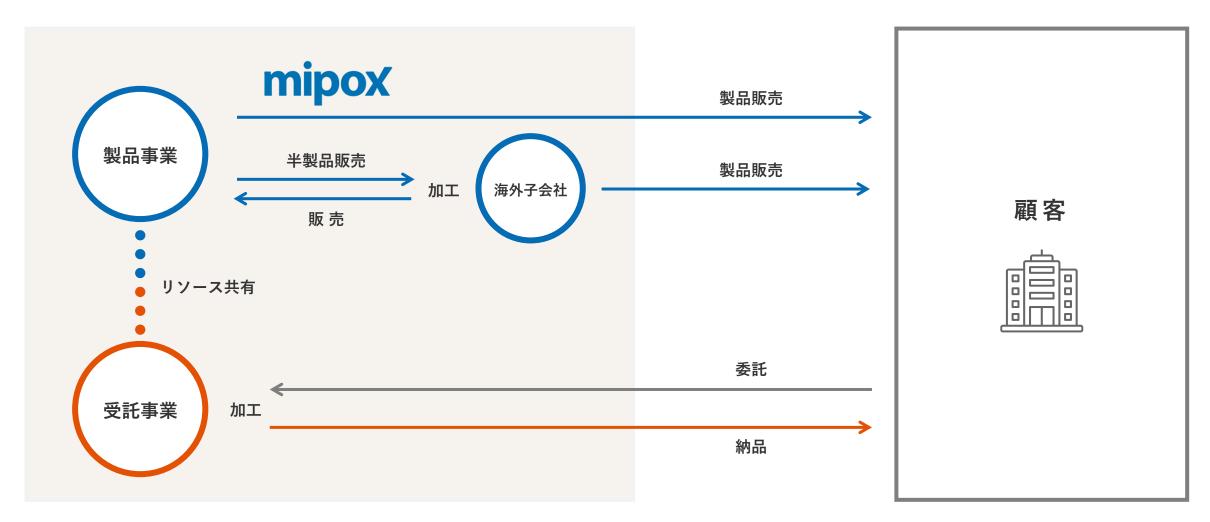
07

Appendix

Appendix



海外工場での加工を経ることにより、日本のみに工場が存在するよりも様々な製品を効率よく製造しております。海外向けに販売も行っております。 顧客からの委託を受けて加工も行っており、自社製品のみならず顧客の要望に合わせたサービス・製品も提供しております。



製品事業

研磨材の開発・製造・販売を行っております。 超精密研磨から一般研磨、装置や反射材など、世界中の幅広い用途に



研磨フィルム



向けて当社製品を提供しております。

液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



研磨周辺機器



検査装置



再帰性反射材 (Ref Lite)



ヤスリ製品



IH粉体塗装

受託事業

【受託研磨加工】

半導体ウェーハをはじめとする材料を顧客より預かり、弊社が保有する設備(研磨装置、洗浄機、検査装置)と独自の研磨材を用いて、要望に沿った研磨加工を提供しております。

【受託コーティング・スリット】

顧客の基材(フィルム等)や塗料材を預かり、弊社が保有する設備 (調合、コーティング、スリット)を用いてフィルム化、裁断を 行っております。



塗布製品



研磨加工



スリット加工



常温接合加工



検査

評価技術 加工技術 製品事業 受託事業 バルクウェーハ完成 半導体ウェーハ完成 半導体チップ完成 評価技術 バルクウェーハ製造 工程 半導体製造 工程 実装 単結晶引上工程 名古屋大学共同研究、NEDO 若手研究 NEDO 先導研究 半導体 前工程 省電力化、省スペース化 者発掘支援事業。半導体製造の生産性を向上 プログラム =高密度化(積層技術) PC基板 させるキラー欠陥。自動検査システムの開発 大型SiC結晶 素子形成・配線形成・ウェーハ特性検査 専用 例)生成AI、次世代半導体 バルクウェーハ加工 (インゴット) に 半導体 後工程 プローブカード向け アライメント機材あり 研磨材 対する欠陥・内部歪の クリーニングシート製品 (位置決め接合) 組立・検査 観察解析技術 (終了) 評価技術 製品事業 製品事業 受託事業 受託事業 複雑な工程を当社が一括管理。ワンストップソリューション 当社が関わる工程 バルクウェーハ加工 工程 NEDOグリーンイノベーション (GI) 基金 加工技術 大口径SiCウェーハ加工ラインの開発、ウェーハ加工工数の削減 インゴット **NEDO**グリーンイノベーション スライス (GI) 基金 外周 ラップ加工 ポリッシング 洗浄 ▶ ベベル加工 接合 エッジ 平面 加工 溶液法におけるSiC結晶の 研削加工 (外周面取り) (粗研磨) (鏡面表面) 加工 研磨 研磨 評価技術確立 大口径ウェーハ観察装置の開発 評価技術 次世代半導体(パワー半導体) ウェーハ スラリー 研磨装置ベベル 高出力パワーモジュールの実現 熱設計(ヒートシンク)接合研磨加工サービス 製品事業

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

_2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 Q1 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecas

04

事業内容

Our Busines:

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix



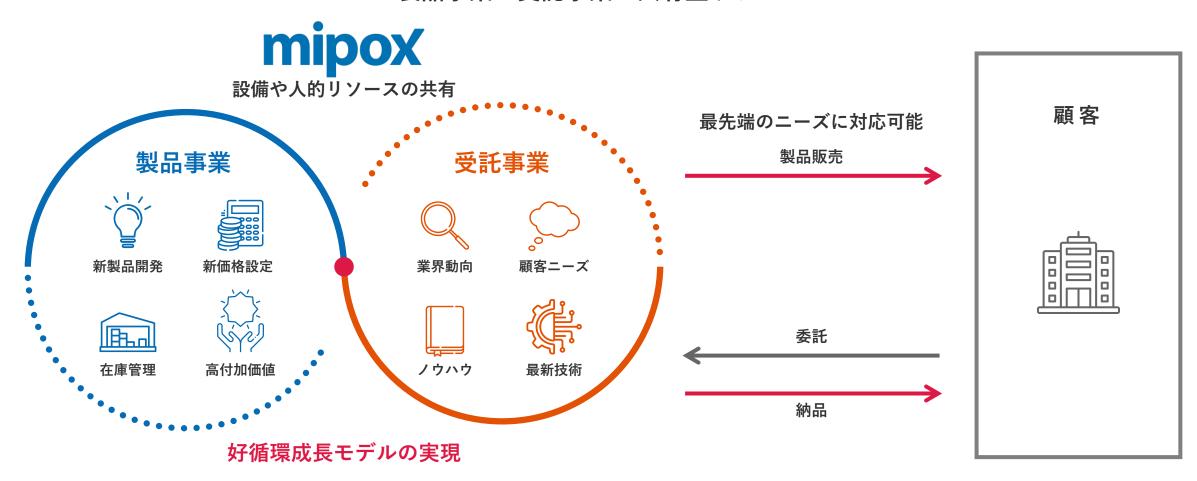
1 事業間で発揮されるシナジー効果

2 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

3 スマートファクトリー

製品事業と受託サービス事業では設備や人的リソースを共有しており、技術やノウハウの蓄積に役立っております。 蓄積された技術やノウハウは高付加価値のある製品やサービスの創出に活かされ、顧客の多様な要望を実現する源になっております。

製品事業と受託事業の共有型リソース



製品製造と受託加工ができるため、顧客の理想に合わせた製品の作成、きめ細やかなサービスの提供が可能です。 各製造工程において異なる取引先との煩雑なやりとりを当社がワンストップで提供しており、顧客の要望が1つの窓口で完結いたします。

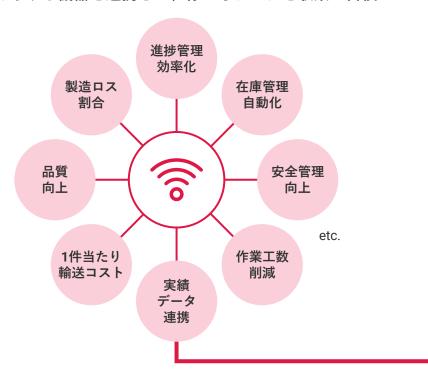




IoTとAIを活用し連携させることで、可視化しづらい部分の改善に役立つデータを収集しております。 工場のDX化により、さらなる効率化・高品質化を目指します。

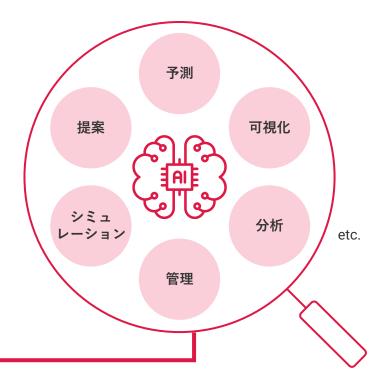
loT

あらゆる機器を連携させ、様々なデータを収集・蓄積



Al

IoTで集めたデータを分析して課題を見える化



業務プロセスの改革

品質・生産性の向上

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 01 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Busines

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix

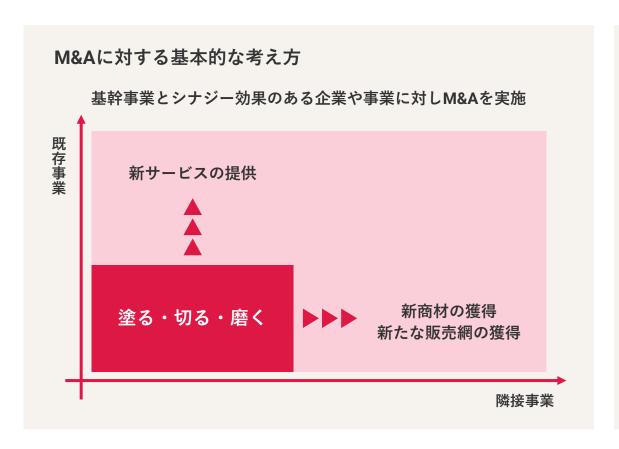


1 製品・受託事業領域の拡張

2 鹿沼事業所の量産体制構築

3 産官学プロジェクトへの参画

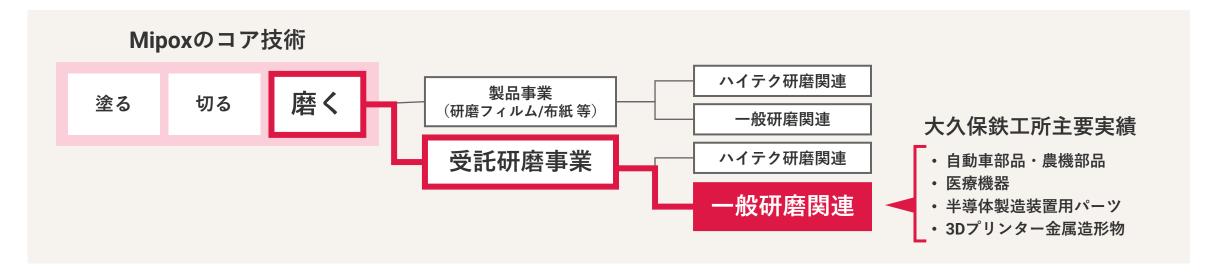
当社の基幹技術「塗る」「切る」「磨く」の事業領域を拡大するための打ち手として、M&Aを実施してまいりました。 今後も製品・受託事業領域の拡張を行ってまいります。





多様化するニーズに、迅速且つ的確に対応できる体制の構築

2023年10月31日に大久保鉄工所をM&Aにて取得、これにより当社の主要事業すべてにおいて一般研磨用途の参入が可能となり、 さらなる対象市場の拡大と新規顧客の獲得が期待されます。





今後の展望

- 受託研磨事業の対象市場拡大(自動車・農機・医療・3Dプリンター業界など)
- Mipoxの営業ネットワークを活用した新規顧客の獲得







2023年4月より本社を東京オフィスから鹿沼事業所に移転し、本格稼働を開始いたしました。 今後、計画的に人員・設備・機械の増強を行いながら、更なる生産能力の拡大に努めてまいります。

鹿沼事業所

敷地面積:約60,000㎡ 延床面積:約46,000㎡

取得日 2022年4月1日

取得目的

- ・ 受託事業の生産能力拡大
- ・事業成長のための場所確保
- BCPの観点から生産体制のリスク分散

受託研磨加工

スリット工程

塗布工程

環境配慮設備

ダイカット工程

物流



鹿沼事業所の稼働状況

- ・ 受託塗布・スリットの稼働を開始
- ・ タイ子会社、京都工場からの生産移転
- ・ ㈱スガ コーディングスのIH塗装事業の稼働開始
- ・ 東の物流拠点としての機能を集約
- ・ 使用面積増加も可能 (未使用エリアは他社へ貸与中)

研磨ラボの活用

• 顧客と一体で研磨プロセス、製品開発を進められる体制を構築し、 初期ニーズの把握を行い、付加価値が高く迅速な製品提供を展開予定



3つのNEDOプロジェクトに参画しております(うち1プロジェクトはすでに終了)。 加工技術と評価技術の確立においてさまざまな組織と協力し、国主導のプロジェクトを進めております。

PROJECT 01

NEDOグリーンイノベーション基金事業 - 次世代デジタルインフラの構築 -

オキサイドを幹事会社として(株)UJ-Crystal、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学、アイクリスタル株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所が参画

- ・最初の2年の委託事業を当初想定通りの成果で終了し、本年度から助成期間に移行
- ・今期はパイロットライン各装置の立上げ・工数削減・シミュレーション技術の構築を目指し、検査装置の量産化検討を実施

加工技術

大口径SiCウェーハ加工ラインの開発

8インチ対応SiCウェーハ加工、パイロットラインの構築

ウェーハ加工工数の削減

加工シミュレーションの検討と削減工程候補の抽出

評価技術

溶液法におけるSiC結晶の評価技術確立 溶液法SiCに適した光学系の最適化とそれに基づく装置設計

大口径ウェーハ観察装置の開発

8インチウェーハに対応した装置使用の検討と設計

PROJECT **02**

NEDO官民による若手研究者発掘支援事業 名古屋大学 (原田俊太准教授)

・デバイスメーカーとの連携によりデバイス不良との相関を確認し、デバイスキラー欠陥検出もしくはウェーハ品質スクリーニングが可能な量産装置の構築 を目指す

評価技術

半導体製造の生産性を向上させるキラー欠陥 自動検査システムの開発

2023年8月論文発表

PROJECT 03

NEDOマテリアル革新技術先導研究プログラム 電力中央研究所・名古屋大学(宇治原徽教授)・理化学研究所

2022年度末に終了

・2022度末に終了し、製品化に向けた開発を継続

評価技術

大型SiC結晶に対する欠陥・内部歪の観察解析技術

SiCインゴット検査装置の開発

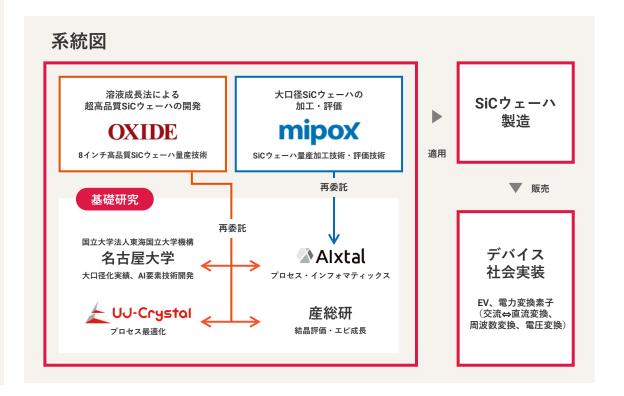
カーボンニュートラルの実現に向けてエネルギー構造や産業構造の転換、大胆な投資によるイノベーションの創出が必要とされいます。 これまでの社会の延長にない飛躍的な目標を達成するため創出された、グリーンイノベーション基金のプロジェクトに当社が参画しております。

NEDO*1グリーンイノベーション基金

- ・ 日本政府が主導する 「2050年カーボンニュートラル」宣言を達成するための基金
- ・事業予算2兆円
- カーボンニュートラルに向けた研究開発、実証から社会実装に取り組む企業 に最長10年間支援

プロジェクトの目的

超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発・販売



*1:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

Agenda

01

会社概要

Company overview

02

_2025年3月期 第1四半期 実績

FY2025 Q1 Financial Results

03

通期業績見通し

Full Year Forecast

04

事業内容

Our Busines:

05

競争力の源泉

Competitive Advantage

06

成長戦略

Growth Strategy

07

Appendix

Appendix



変わることを忘れない 『100年ベンチャー』

当社は1925年にドイツ・レイボルト商館の子会社として創業し、輸入した顔料を販売する傍ら主に出版物に使われる色箔の製造を生業としておりました。1960年代後半よりこの色箔を製造する中で培った「塗る」技術、それを裁断する「切る」技術を基に、精密部品の製造工程事業に使用される研磨フィルムを開発し、「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術を確立いたしました。

精密研磨材専業メーカーとして発展を経て、2000年初頭からはコア技術である『塗る』をサービスとして提供するエンジニアリングサービス(受託塗布)を開始いたしました。創業来の危機である2008~2010年を乗り越えたあとは、『磨く』をサービスとして提供するウエハープロセス(受託研磨)を立ち上げ、「塗る・切る・磨くで世界を変える」に取り組んでまいりました。 2016年には研磨布紙メーカーである日本研紙を仲間に迎え、製品事業のラインナップの拡充を進めました。

創業から間もなく100年。事業を長く続けていくために、急速に変化するテクノロジや世の中の価値観を敏感にとらえながら、自らも変化に順応していくことが求められます。こうした時代のニーズに対応するため、わたしたちが培ってきたコア技術をさらに高めながら、新しい事業にも積極的にチャレンジし、世の中に必要とされる製品やサービスを通じて世界のお客様に選ばれるパートナーを目指してまいります。

変わることを忘れない、『100年ベンチャー』を目指してこれからも変化し続ける集団でありつづけます。

今後とも皆様のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 渡邉 淳



01



代表取締役社長 渡邉 淳 WATANABE Jun

日本とアメリカの大学で学んだ後、1994年当社へ入社。製造現場でキャリアをスタートし、生産技術、国内営業、海外営業を担当後マレーシア駐在員、米国子会 社赴任を経験。その後半導体部門長、海外支援部門長に従事。2007年取締役、2008年に先代から引き継ぐ形で現職に就任。就任後は不採算事業撤退や拠点の統廃 合を通して赤字からの脱却を行った。業績回復後は製造業として「技術・品質」に加え、デジタルを企業変革の柱と据えてIT推進をリード。

02



取締役 中川 健二 NAKAGAWA Kenji

全自動水洗い洗濯機や半導体CMP後洗浄装置の開発、ハードディスクメディアむけ研磨テープや光学検査装置の技術営業を経験。独立後は光学検査装置のマーケティングから技術、営業や貿易などに携わる。2002年に独立後、2016年当社技術本部長、2019年経営企画部長兼経営管理部長に就任。経営全般に関わりながら、社内組織体制の構築やレフライトのリブランディング活動に注力。2021年から新事業開発に携わり、GI基金の大口径SiCウェーハの加工開発を統括している。

03



取締役 上谷 宗久 UETANI Munehisa

2000年に当社入社。台湾支店長や海外子会社の代表取締役を経て、2012年取締役営業本部長に就任。製造拠点の運営、競合他社とのM&A、そして民事再生を経た企業の事業承継等を担当。2017年に退職し、ITベンチャーにおける取締役COOとしての経験をはじめ、エンジニアリング企業での事業開発責任者としての役職を経た後に、2022年4月に当社に復帰。外部活動としてthomas株式会社の社外取締役も務める。

04



社外取締役(独立役員)長井 正和 NAGAI Masakazu

長瀬産業にて1973年から半導体を中心とする精密電子回路製造用機材の海外営業に25年間従事。1988年から6年間シリコンバレーに駐在し、三次元半導体パッケージ設計技術の日米企業間コラボを推進。2003年に独立し、トランスエッジ有限会社の代表として現在に至るまで主に半導体・回路板の技術・マーケティングのコンサルティングに従事。

05



社外取締役(独立役員)加藤洋美 KATO Hiromi

2007年12月に弁護士登録をし、日比谷法律事務所に入所。以降、法律業務に従事し、2021年4月には同事務所の所長に就任。現在も所長として業務を遂行中。また、2021年4月からは小岩井農牧株式会社の監査役を務めており、2023年4月には株式会社小岩井ファームダイニングの監査役にも就任し、同様に現任している。

社外取締役(独立役員)

加藤 洋美

		経営全般	グローバル 経営	ESG	DX戦略	財務・会計	研究・ 技術開発	M&A	マーケティング・ 営業	製造・ 生産技術	法務・ リスクマネ ジメント
01	代表取締役社長 渡邉 淳	•	•	•	•			•		•	
02	取締役中川健二						•		•	•	
03	取締役 上谷 宗久		•		•			•	•		
04	社外取締役(独立役員) 長井 正和	•	•				•		•		

当社では、次世代を担う人材の育成と長期的なキャリア形成を重視しています。そのため、以下のような多様な取り組みを行っています。

採用や育成に関する取り組み

【工場見学およびインターンシップ】

高校生を対象に工場見学やインターンシップを実施し、職業体験を通じて実際の業務を理解してもらう機会を提供しています。これにより、若い世代の興味を引き出し、将来の採用につなげています。

【OJT教育と研修制度】

当社の教育プログラムはOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を中心に構成されています。新入社員は現場での実務経験を積むことで、実践的なスキルを身につけます。また、各部署やキャリアパスに応じてフォローアップ研修を行い、継続的な成長を支援しています。具体的な研修内容としては、入社時研修、拠点間研修、ビジネススキル研修(外部研修)などがあります。

【新卒定着率】

当社の新卒定着率※は83.3%と高く、これは充実した研修制度と働きやすい環境が実現されている証です。新入社員が長期にわたり安心して働けるよう、支援体制を整えています。

- *過去5年採用新卒定着率。国内データに基づく。
- *2024年3月末現在



当社では、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、柔軟で多様な働き方を推進しています。



平均残業時間 15~17時間/月

> 男性育休取得率 16.7%

働き方に関する取り組み

【在宅勤務とスーパーフレックス制度】

働く場所や時間に柔軟性を持たせることで、従業員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにしています。

【ハレアワー制度】

社員がリフレッシュし、仲間との絆を深めるために、時間単位で取得できる休暇制度です。具体的な活動例としては、部や課の全員でプロスポーツの応援に行く、花見や暑気払いを行う、打ち合わせ後に全員でボーリングに行くなどが含まれます。この制度は社員全員がリフレッシュし、良好な人間関係を築くことを目的としています。

【地域貢献活動】

小中学生を対象とした「研磨加工教室」の開催や定期的な公園美化活動の実施等を通して、地域社会への貢献を大切にしています。

【社内行事】

当社が大切にしている『みんな仲良く』の精神を実現するため、また「働き方改革」の一環として、社内行事を積極的に実施 しています。これにより、社員間のコミュニケーションが深まり、より良いチームワークが築かれています。

【残業時間の管理】

当社の従業員の**平均残業時間は月15~17時間***を推移しています。具体的な目標数値は持っていませんが、バランスの取れた働き方を重視しています。

【有給休暇取得率】

有給取得率の**目標を80%**と設定しており、現状では**83.3% ***です。これにより、従業員のワークライフバランス向上を図っています。また、**男性育休取得率は16.7% *** となっております。

当社では、従業員のエンゲージメントを高め、働きがいのある職場環境を実現するために、以下の取り組みを行っています。

エンゲージメントに関する取り組み

【COMPASSの作成】

当社の指針となる「COMPASS」を作成し、全従業員に共有しています。 この指針は、企業理念やビジョン、行動指針を明確にし、従業員が日々 の業務において共通の目標と価値観を持つための基盤となっています。

【定期的なアンケートの実施】

従業員の声を直接反映させるために、定期的に従業員サーベイ(ウェルビーングサーベイ)を実施しています。このアンケートでは、従業員の満足度や不満点を収集し、それに基づいた具体的な対策を講じています。 従業員の意見を積極的に取り入れることで、働きやすい環境の整備とエンゲージメント向上を図っています。

これらの取り組みの結果として、当社の**退職率は11.6%(グローバル**)となっており、従業員が長く安心して働ける環境が整っています。これからも、従業員の声を大切にし、エンゲージメント向上に努めてまいります。



当社では、安全と適正を最優先に考え、職場環境の最適化に向けた取り組みを積極的に行っています。



健康・安全に関する取り組み

【5S活動】

5つの要素からなる5S活動を推進しています。これにより、職場の安全性を向上させ、効率的な作業環境を整えています。

◆5Sとは

整理 Seiri : いらないものを捨てる

整頓 Seiton : 決められたものを決められた場所に置き、取り出せる状態にしておく

清掃 Seisou : 常に掃除する

清潔 Seiketsu : 3S(整理、整頓、清掃)を維持し、職場の衛生を保つ

躾 Shitsuke : 決められたルールを守る、手順を正しく守る、習慣をつける

当社は生産性向上のための業務効率化を行っています。

安全性、快適性の高い工場を目指し、決められたルールを当たり前に守る風土を作り、会社の信用度、会社の利益に繋げます。

安全で安心して働ける職場環境の維持と向上に努めています。

当社では、多様性を尊重し、誰もが活躍できる職場環境の実現に向けた取り組みを進めています。

ダイバーシティに関する取り組み

【男女別従業員比率】

従業員比率は**男性:女性が3.5:1(グローバル**)となっています。これに対して、女性の採用や昇進の機会を増やす取り組みを進めています。

【男女別賃金格差】

男女間の賃金格差は61.1%(国内のみ)です。なお、属性(勤続年数、役職等)が同じ男女労働者間での賃金の差異はありません。

【女性管理職比率】

女性管理職比率は11.6%(グローバル)です。女性リーダーの育成プログラムやメンター制度を導入し、女性が管理職として活躍できる環境作りを推進しています。

【障がい者雇用比率】

障がい者雇用比率は1.8%(国内のみ)であり、目標の2.7%(2026年までに)に向けて取り組んでいます。職場のバリアフリー化や障がい者向けの職務設計を進めることで、働きやすい環境を整備しています。



障がい者雇用比率 1.8%

Environment



- ・ 太陽光パネル導入の推進
- ・ IH粉体塗装システム
- · RTOの利用によるVOC削減
- LNGボイラの導入
- ・ リサイクル素材を使用した製品の開発
- ・ グリーンイノベーションへの取り組み
- ISO14001 にもとづいた環境負荷軽減









Social



- ・ Eラーニングによる社内教育の充実
- スーパーフレックスタイムの導入
- ・ 人事評価システムの構築
- ・ 資格取得の促進および取得後の手当の充実
- 労働災害事故の防止
- 若手の定着率の向上
- 女性従業員比率の向上





Governance



- 透明性のある情報開示
- 内部通報窓口を外部企業に委託
- ・ 全社員に対するコンプライアンス研修の実施
- グループ各社に対するガバナンスとモニタリング 体制の強化













IRお問い合わせ

https://www.mipox.co.jp/inquiry.html



フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様への お問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。 HPのお問い合わせフォームをご利用ください。



















